

解决方案：IC设计行业ERP解决方案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/207/2021_2022__E8_A7_A3_E5_86_B3_E6_96_B9_E6_c40_207206.htm IC设计行业解决方案

IC设计行业背景IC设计业已成为半导体产业链中的明日之星，尤其在景气低迷之际，IC设计业的发展倍受瞩目，由于IC设计的脑力密集型特性，加上越来越多的IDM厂商也跨入Fabless模式，因此在整个半导体产业链中，在IC市场诡谲多变的情况下，仍然有着优异的营运与获利表现。与此同时，IC设计业也是目前最具挑战的产业之一。作为IC设计业者不仅要承担Time to Market的挑战，同时也必须承

担Time-To-Revenue的挑战，一个产品从晶圆投片到成品需耗时30天至120天不等。而这段时间中，下游电子组装业的半导体零组件的采购需求，却可能因最终消费者与市场通路的快速变化，如云霄飞车般的快速上下起伏。对于IC设计业而言，一方面要快速推出产品抢占市场，同时又要谨慎的检视手上的成品库存与半成品库存、外包合作厂商的在制品的生产状况，以及在晶圆代工厂投片的生产进度，以决定未来的投片与投料计划面临着IC设计业在管理上的特殊需求。IC设计行业所面临的管理问题1. 如何管理不同光罩版本，不同封装形态，不同测试流程，不同包装方式下不同形态的产品？2. 如何精确掌握单一原料经不同制程最终产出多样产品分布状况？3. 如何建立料号关系用以适应多料号转Code及厂内厂外不同料号的需求，管理不同业务阶段管理所需的产品编号？4. 接单时如何推算出预计完成品产出日期及DIE数，以预推允交期及允交量？5. 如何迅速确实的掌握在各外包厂目前所

有Wafer Lot在制品的生产状况，为公司相关部门提供管理的依据？6. 如何管理外包厂商处的Wafer Bank，以及具体接到客户订单后的转Code作业？7. 如何实现产品测试动态分Bin的管理？8. 如何实时、详尽了解每一外包站程的Wafer片数、晶粒数、Cycle Time及Yield Rate等相关信息。9. 如何即时管控采购或外包的Yield Rate？10. 如何在算出其月加权单位成本以满足报税要求的同时，试算出每个批号的批次成本，以及该批中平均良品Die的单为成本为何，以方便成本人员能够针对批作差异分析？11. 如何灵活处理在采购、外包及库房管理中各个作业阶段需要的拆批、并批需求，以及如何方便的追溯各批号之间的关系？

GuruERP IC设计行业解决方案明基逐鹿软件(苏州)有限公司针对IC设计产业所开发全新的GuruERP ICD系统，符合IC设计公司的产业特性，系统的符合度傲视群雄，有效整合组织内部的流程及资源。我们在IC设计产业上下游的客户群众多，导入经验丰富，所以不仅能深入产业，更能了解实际作业时的流程及各项需求。

明基逐鹿软件IC设计行业解决方案流程图：

1. 整合公司信息，使业务，计划，仓管，采购，生产，各个职能部门之间的信息流动通畅，分享及时。迅速确实的掌握在各外包厂目前所有Wafer Lot在制品的生产状况，让生物管库同仁可以非常有效率的进行委外生产、回货与库房调度等作业。
2. 建构企业内的标准作业流程及与外部电子化B2B的桥梁，使相关人员可以在不同的时间及地区实时查询公司内部信息或建立资料达到零时差同步处理的服务。
3. 提供精准的生产资讯如：料况、良率与生产成本等资讯给相关部门同仁使用，减少目前大部份以人工操作的模式，以实时协助 / 警示生产管理者对各资源进行有效的调整

，分配，修正决策，让生管与财务同仁在月底与外包商对帐结帐的作业可以在最短的时间内完成 .4. 让外包的生产资讯可以毫不费力的就流入，并让公司相关部门的同仁可以即时检阅这些资讯，协助IC设计公司与晶圆厂及各个不同的外包厂、供应商及客户做有效率的生产规划管理及联系。5. 加快订单、物流的处理速度，提升企业的运作效率，降低库存，提高资金周转率，加强客户信用控制，预防呆账、坏帐。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com